

证券代码：688249

证券简称：晶合集成

公告编号：2024-032

合肥晶合集成电路股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份达到 2% 暨回购进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2023/12/25
回购方案实施期限	2024年3月15日~2025年3月14日
预计回购金额	500,000,000 元~1,000,000,000 元
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	40,155,756 股
累计已回购股数占总股本比例	2.00%
累计已回购金额	570,950,811.31 元
实际回购价格区间	12.97 元/股~15.31 元/股

一、 回购股份的基本情况

2023年12月22日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金、自有及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于股权激励。回购资金总额不低于人民币 50,000 万元（含），不超过人民币 100,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 25.26 元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶合集成关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告（更正后）》（公告编号：2023-042）、《晶合集成关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-017）。

二、 回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，在回购股份期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至 2024 年 5 月 22 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 40,155,756 股，占公司总股本 2,006,135,157 股的比例为 2.00%，与上次披露数相比增加 0.58%，回购成交的最高价为 15.31 元/股，最低价为 12.97 元/股，支付的资金总额为人民币 570,950,811.31 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

上述回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。

三、 其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会
2024 年 5 月 24 日